

HPWV-190 填孔钨浆

HTCC 系列

日期：2023.1.1 编号：HP-PAS-67

1. 产品描述

本说明书适用于公司制造的 HPWV-190 产品，主要用于氧化铝基高温陶瓷的金属化或高温共烧陶瓷工艺（HTCC）的填孔电极的制作。产品为无铅、无镉环保型号，满足 Rohs 标准。

2. 产品性能参数

性能\品名	HPWV-190
用途	填孔
无机物含量(%)	89±1
粘度(Pa·S)	4000~14000
细度(μm)	≤15 (90%)

注：粘度采用 Brookfield HBDV-II+粘度计，CP7#转轴；转速：1.0rpm，测定温度：25.0±0.5℃；

3. 使用推荐工艺与方法

- ①印刷工艺：不锈钢印刷。
- ②干燥条件：60-150 °C/10min。
- ③烧结条件：还原气氛，1500-1650 °C/120min（峰值）。
- ④稀释剂：正常浆料无需稀释。如有少量挥发，请与生产商联系后，根据需要加入适量的特定稀释剂。

4. 储存和储存期

密封 25℃阴凉条件下保存,储存期 6 个月。若有条件请在 10℃以下冷藏，但使用前要取出在室温慢速滚动 6~10 小时。

5. 注意事项

- ①电子浆料属于可燃物品，请远离热源或火源。
- ②不可吞食，接触皮肤时请及时清洗。
- ③久置可能会出现分层现象，充分搅拌后不影响使用。

苏州泓湃科技有限公司

地址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城中西北区 2 栋 电话：0512-81668260 网址：hongpaikeji.com